

4. Tiefdruck-Tagung: Erfolgsfaktor Diversifizierung im Verpackungsdruck

Agenda day 1 Tuesday, 11.11.2014

7:45	Frühstücksimbiss im Foyer und Registrierung
8:30	Karsten Schröder <i>Innoform Coaching GmbH</i> Eröffnung • Einführung in die beiden Tage
8:45	Thomas Baum <i>Sweet Tec GmbH</i> Marktanforderungen für flexible Verpackungen aus der Sicht eines mittelständischen Unternehmens der Süßwarenindustrie • Veränderung der Handelslandschaft und ihrer Sortimente • Rechtliche Anforderungen und Veränderungen • Ökonomische und ökologische Herausforderungen, auch für den Folienhersteller
9:25	James Siever <i>European Rotogravure Association (ERA) e.V.</i> Anforderungen der Markenartikler an die Drucker ihrer Verpackungen • Trends im Verpackungsdruck • Vorteile der verschiedenen Druckverfahren • Ergebnisse der GfK-Studie
10:05	Pause mit Kaffee und Tee
10:45	Prof. Lutz Engisch <i>Sächsische Walzengravur GmbH</i> Direktgravur - neue Chancen und neue Herausforderungen • State-of-the-Art Analyse der gängigen Direktlasergravur-Systeme für Druck- und Prägeanwendungen • Workflow - Neue Anforderungen für alle • Laser finishing - macht mehr als nur sauber • neue Produkte - neue Anwendungen • neue Herausforderungen - in Technologie und Business
11:25	Rolf Semmler <i>ENULEC GmbH</i> Elektrostatik - Gefahren und Chancen • Neue Kontrollmechanismen der Elektrostatik im Tiefdruckprozess • Mehr Sicherheit durch Einsatz einer ESA? • Vermeidung von Gefahren im Druck- und Converting-Prozess
12:05	Gemeinsames Mittagessen
13:15	Harald Gruber <i>Constantia Teich GmbH</i> Tiefdruck im wirtschaftlichen Umfeld von Kleinstaufträgen aus Sicht eines Herstellers von flexiblen Verpackungen • Losgrößenverteilungen • Indikationen resultierender Herstellkosten im Tiefdruck und UV-Flexodruck • Folgen und notwendige Entscheidungen
13:55	Uwe Richter <i>Uwe Richter Farbkommunikation</i> Wie viele Farbkorrekturen können Sie sich leisten? • Ursachen für Farbkorrekturen • Eindeutige Definition von Farben • Optimierung der Farbrezeptierung • Messgeräteunterschiede • Messunterlagen
14:35	Päuschen

15:10

Dr. Andreas Grabitz
FCMExperts GmbH

Druckfarbenverordnung und Auswirkungen für die Drucker

- Was steht drin?
- Was bedeutet das in der Praxis?
- Mögliche Stolperfallen

15:50

Stefan Beilenhoff
print.con Beilenhoff Consulting

Digitaldruck – Wettbewerb oder Chance im Produktionsumfeld des Tiefdrucks?

- Digitaldrucksysteme im Überblick – heute und aktuelle Entwicklungen
- Besondere Chancen für Newcomer und etablierte Verpackungsmittelhersteller
- Herausforderung: „Von der Serienproduktion zum Unikat“

16:30

Ausklang des ersten Tages und Vorbereitung auf's Rampendahl

18:30

Gemütlicher, traditioneller Bierabend mit Abendessen in der Gaststätte Rampendahl

4. Tiefdruck-Tagung: Erfolgsfaktor Diversifizierung im Verpackungsdruck

Agenda day 2 Wednesday, 12.11.2014

7:15	Frühstücksimbiss im Foyer
8:00	Harry Sieljes <i>adapa the Netherlands Amersfoort BV</i> Continuous Success in Short Run / Narrow Web Flexible Packaging with Gravure and VSOP Offset Presses • Principles of technology & organization for short run printing • Limitations for the business model • Efficiency and cost comparison of 3 Rotomec MW 60 gravure presses vs. 1 VSOP web offset press incl. flexo and gravure units • Future challenges for technology & organization in short run / narrow web flexible packaging
8:40	Dr. Matthias Henker <i>Flint Group Packaging Inks Germany GmbH</i> Haftung von Druckfarben - Voraussetzungen, Mechanismen und Prüfung • Benetzung von Substraten • Haftmechanismen • Zusammensetzung der Farben und Wirkung von Haftvermittlern und Vernetzern • Was sagt der Tesa-Test über Haftung und Kaschierergebnis?
9:20	Kaffeepause und 2. Frühstück
9:55	Jürg Schleuniger <i>CSEM SA</i> Gedruckte Elektronik: Herausforderungen und Möglichkeiten - Teil I • Gedruckte Elektronik im Überblick • Bauteile (OPV, OLED, oTFT, Sensoren) - Aufbau und Besonderheiten • Herstellung und Resultate von gedruckten Transistoren • Herausforderungen beim Drucken von elektronischen Bauteilen
10:25	Dr. Gerald Jenke <i>SAUERESSIG Group (Matthews International GmbH)</i> Gedruckte Elektronik: Herausforderungen und Möglichkeiten - Teil II • Fertigungsanlagen für gedruckte Elektronik • Anforderungen an die Tiefdruckform • Direktstrukturierung von Tiefdruckzylindern mit Mikrostrukturen • Neue Werkstoffe für Tiefdruckformen
10:55	Dirk Lange <i>AVT-Advanced Vision Technology GmbH</i> Digitale Vernetzung und automatisierte Qualitätssicherung – Produktivitätsoptimierung durch permanente, automatisierte und vordefinierte Drucküberwachung im Tiefdruck • Weniger Makulatur durch eine automatisierte Inline Prozesskontrolle • Kundenwünsche erfüllen und Reklamationen vermeiden durch Qualitätsdaten-Management • Individuelle Automatisierung des Informationsflusses - von der Repro bis zur Rampe
11:35	Oliver Leithäuser <i>COMEXI Group Industries S.A.U.</i> Ist der Tiefdruck für kleine Auftragsgrößen ins Hintertreffen geraten? • Anforderungen an das Druckverfahren der Zukunft • Herausforderungen des Maschinenbauers mit Blick auf neue Maschinengenerationen
12:15	Karsten Schröder <i>Innoform Coaching GmbH</i> Zusammenfassung • Die Highlights der 2 Tage kurz und knapp
12:25	Gemeinsames Mittagessen
13:30	Ausklang